

LEITERPLATTENFERTIGUNG | ÜBUNGSLEITERPLATTE

SCHÜLERNAME:

26062017-1

Arbeitsgang	Uhrzeit
Grobzuschnitt Leiterplattenmaterial FR4, 1,5mm 35/0 (Endmaß der Leiterplatte + je 10mm)	
Löcher mit CNC-Bohrmaschine automatisch bohren	
Filme deckungsgleich übereinanderkleben	
Blaue Schutzfolie von gebohrter Leiterplatte abziehen	
Film mittels Passmarken auf das Bohrbild der Leiterplatte einpassen	
Leiterplatte mit UV-Licht (4min=240sec) belichten	
Leiterplattenschutzlack (= Ätzresist) entwickeln (Ätznatron)	
Leiterplatte unter Wasser spülen	
Leiterplatte ätzen (Säure: Natriumpersulfat)	
Leiterplatte unter Wasser spülen	
Ätzresist stripfen, 10min (Lauge: Ätznatron hoch konzentriert)	
Leiterplatte unter Wasser spülen	
Leiterplatte trocknen (Druckluft)	
Löcher mit Dremel manuell Bohren (Durchmesser 0,9mm)	
Endzuschnitt (Kreisäge und Schleifbock)	
Oberflächenreinigung (Schmirgelblock)	
Oberflächenveredelung (Lötack SK10)	

Platinengröße: 50x55mm